



Hauptmerkmale

Produktserie	Modicon M580
Produkt oder Komponententyp	Prozessormodul
Imprägnierungsmaterial	Schutzlack

Zusatzmerkmale

Anzahl von Racks	8
Local I/O processor capacity (discrete)	6144 E/A
Local I/O processor capacity (analog)	1536 E/A
Number of application specific channel (local rack)	216
Anwendungsspezifischer E/A	Serielle Schnittstelle HART Motion Control Genaue Zeitstempelung SSI-Encoder Zähler
Prüfungen	Prozesssteuerung
Steuerkanäle	Programmierbare Regelkreise
Integrierte Schnittstellen	1 Ethernet TCP/IP für Service-Port 2 Ethernet TCP/IP für Gerätnetzwerk USB Typ Mini-B
Anzahl entfernter E/A-Stationen	31 - 2 Einbaugeschäfte pro Spannungsabfall, remote
Anzahl verteilter Geräte	64
Kommunikationsmodulprozessor	6 Ethernet-Kommunikationsmodul 24 AS-Interface-Modul
Kommunikationsdienst	RIO-Scanner DIO-Scanner
Speicherbeschreibung	Erweiterbar Flash, 4 GB für Datenspeicherung Integriert RAM, 10 KB für Systemspeicher Integriert RAM, 64 MB für Programm und Daten

Anwendungsstruktur	2 Hilfs-Tasks 1 periodische Fast Task 128 Ereignis-Tasks 1 zyklisch/periodische Master Task
Anzahl der Anweisungen pro ms	40 kAnw/ms 100 % boolesch 60 Kinst/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch
Leistungsaufnahme	295 mA bei 24 V DC
MTBF Zuverlässigkeit	600000 H
Beschriftung	CE

Montage

Vibrationsfestigkeit	3 gn
Stoßfestigkeit	30 gn
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Aufstellungshöhe	0...2000 m 2000...5000 m mit
Relative Feuchtigkeit	5...95 % bei 55 °C ohne Kondensation
Schutzart (IP)	IP20
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie
Normen	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Schutzbehandlung	Conformal coating
Umgebungsbedingungen	Gas resistant class Gx Gas resistant class 3C4 Staubbeständig class 3S4 Sand resistant class 3S4 Salt resistant Stufe 2 Mold growth resistant class 3B2 Fungal spore resistant class 3B2
Produktzertifizierungen	IEC-Ex RCM UL EAC ATEX Handelsmarine CSA CE
Versorgung	Interne Stromversorgung über Modulträger
Status-LED	1 LED (grün) Prozessor in Betrieb (RUN): 1 LED (rot) Prozessor- oder Systemfehler (ERR): 1 LED (rot) I/O Modulfehler (I/O): 1 LED (grün) Downloadvorgang aktiv (DL): 1 LED (rot) Speicherkarten- oder CPU-Flash-Fehler (BACKUP): 1 LED (grün/rot) ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen): 1 LED (grün/rot) Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus): 1 LED (grün) E/A-Werte durch Nutzer überschrieben (FORCED IO):
Produktgewicht	0,849 kg

Nachhaltigkeit

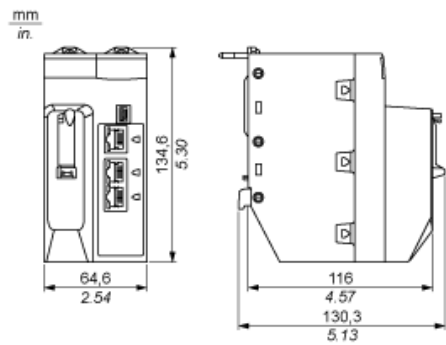
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China

Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

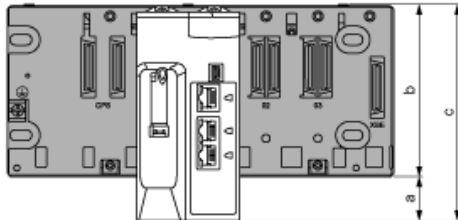
Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nur CPU-Module



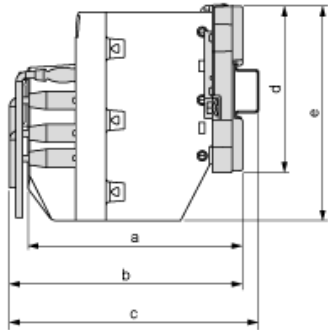
Auf Racks montierte Module



a:
b:
c:

Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm (1.217 in.) Ethernet-Rack:
Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 105,11 mm (4.138 in.).
Die Höhe des lokalen Haupttracks, 134,6 mm (5.299 in.)

In ein Gehäuse montierte Module und Kabel



- a: Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.)
- b: Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)
- c: Verdrahtung + Modul + DIN-Schientiefe: > 156 mm (6.142 in.)
- d: Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.)
- e: Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.)